A pressure sensor includes a body having an inner cavity, and at least two surface acoustic wave (SAW) devices formed on a wall of the inner cavity. In the pressure sensor, the body has an outer flat surface that is adjacent to one of the SAW device in a radial direction.

ID 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 157543

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)7月13日

G 01 L 9/00

A-7507-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全15頁)

劉発明の名称 圧力センサ

②特 願 昭60-299725

②出 顋 昭60(1985)12月27日

砂発 明 者 ピカシュ ケイ シン アメリカ合衆国 コネチカツト州 06896 ウェスト レ

、 ツデイング トツプリツジ ロード 39

砂発 明 者 スタンリー ロツク アメリカ合衆国 コネチカツト州 06851 ノーウォーク

デイアーウツド コート 17

⑫発 明 者 ミツシェル ペ ェク フランス国 75116 パリ ランヌ ブールバール 77

ストロム

⑪出 願 人 シユラムバーガー オ パナマ国 パナマ シテイ 1 カレ アキリノ デ ラ

ーバーシーズ ソシェ グアルディア 8 アパルタド 850

ダ アノニマ

②代理人 弁理士中村 稔 外5名

明 稲 香

1. 発明の名称 圧力センサ

2. 特許請求の範囲

(1) 内側キャピティを有する本体および前記キャピティの壁上に形成された少くとも2つの弾性表面波(SAW)デバイスから成る圧力センサにおいて前記本体は前記SAWデバイスの1つに半径方向に隣接する外側フラット面を有することを特徴とする圧力センサ。

(2) キャビティ壁におけるそれぞれのフラット面にはSAWデバイスが形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のセンサ。

(3) SAWデバイスの双方の側面に位置する壁は 機軸機断面がわん曲されていることを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載のセンサ。

(4) キャピティの壁のSAWデバイスを通る積軸 横断面は一般に多角形であることを特徴とする特 許譲求の範囲第1項記載のセンサ。

(5) SAWデバイスの少くとも1つに隣接するキ

+ビティの壁の横軸横断面はわん曲していることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のセンサ。 (6) それぞれのSAWデバイスにおける本体の半径方向厚さはほぼ同じであることを特徴とする特許款の範囲第1項記載のセンサ。

(7) センサデバイスはセンサ本体の触から半径方向に異なる距離にあることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のセンサ。

(8) それぞれのSAWデバイスに隣接するセンサ 本体の半径方向の壁の厚さは互いに50%より少 い値だけ異なることを特徴とする特許請求の範囲 第7項記載のセンサ。

(9) それぞれのSAWデバイスにおけるセンサ本体の厚さは前記デバイスのそれぞれの熱応答時間の差を少くするよう整合されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のセンサ。

Qu SAWデバイスにおけるそれぞれの厚さはほぼ同じであることを特徴とする特許請求の範囲第9項記載のセンサ。

(11) 前記キャピティの壁は8角形であることを

特徴とする特許請求の範囲第4項記載のセンサ。 (12) 名無形体の辺は暮さが異なることを時代と

- (12) 多角形体の辺は長さが異なることを特徴と する特許請求の範囲第 4 項記載のセンサ。
- (13) 1 つのフラット団における本体の壁は他のフラット面における本体の壁よりも横断団が厚いことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のセンサ。
- (14) 薄い方の模断面を有する本体の壁にはフラット面に隣接するわん曲した側壁が設けられていることを特徴とする特許請求の範囲第13項記載のセンサ。
- (15) 前記わん曲した例望は機断面が円筒形であることを特徴とする特許請求の範囲第 5 項記載のセンサ。
- (16) 前記SAWデバイスからデバイスの周波数差に関連する出力信号を発生するための手段を含むことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のセンサ。
- (17) センサ本体の外側にて圧力を発生する手段 と出力信号を前記圧力の大きさに変換する手段を

合むことを特徴とする特許請求の範囲第16項記 載のセンサ。

- (18) 本体は水晶から形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のセンサ。
- (19) 前記本体は軸方向平面に沿って接合された2つの半分割体から成る円筒体から形成され各々の半分割体の他方の半分割体のチャンネルと対向するよう内部に形成された軸方向延長チャンネルを有し、それぞれのSAWデバイスが形成された底面には軸方向に延長するフラット面が形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のセンサー
- (20) フラット団は2つの半分割体を分離する軸方向平面に平行であることを特徴とする特許請求の範囲第19項記載のセンサ。
- (21) チャンネルは深さが異なることを特徴とする特許請求の範囲第19項記載のセンサ。
- (22) 一方のフラット面における本体の壁の厚さは他方のフラット面における壁の厚さよりも大きいことを特徴とする特許請求の範囲第19項記載

のセンサ。

- (23) フラット面は幅が異なることを特徴とする 特許請求の範囲第19項記載のセンサ。
- (24) フラット面の所定の1つだけが直角よりもかなり大きい角度にて傾斜する側壁に隣接していることを特徴とする特許請求の範囲第19項記載のセンサ。
- (25) フラット面の各々に隣接するそれぞれのチャンネルの倒壁は直角よりもかなり大きな角度にてそれぞれのフラット面から傾斜していることを特徴とする特許請求の範囲第19項記載のセンサ。
 (26) 直角よりもかなり大きな角度にて傾斜する側壁はわん曲されていることを特徴とする特許請求の範囲第25項記載のセンサ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、弾性表面波 (SAW) デバイスを使ったセンサに関する。本発明の重要な特徴は、例えば静水圧等の圧力を測定するため SAW デバイスを使用することに関連する。

特開昭62-157543 (3)

ると、円筒体は屈曲し、SAWデバイス特性を変 える。内部負荷型構造体では円筒体の外面に一つ 以上のSAWデバイスが設けられ、円筒体中の中 心開口に外方からの圧力が加えられる。弾性表面 波センサは、1982年9月29日出願された米 国特許出願第427.240 号(本出願人に譲渡され係 属中である)に詳細に説明されている。よってこ の1982年の米国出願の全内容は参考のため本 発明の一部に記載されている。この米国出願中に 説明または引用された従来技術について審査官は 注意を向けられたい。上記出願と同時に出願され た米国出願第 号(本出願人に譲渡)に このようなデバイスの改良が開示されているので、 この全内容を参考のため本明細書の一部として記 載する。ここに記載または引用された従来技術に ついて審査官は注意を向けられたい。

外部負荷型構造体を製造する一つの方法は、<u>水</u> <u>品</u>等の材料の中実円筒体を用意し、これを軸平面 に沿って半分にのこぎりで切断し、半分割体の平 らな側面にルート(通路)形成し、底部にそれぞ

れ「フラット面」を有するチャンネルを形成する。 「フラット面」なる用語は本明細書では、裏面上 にSAWデバイスを形成するのに充分平らな衷面 を意味し、この表面は平面状でもわん曲状でもよ・ い。各フラット面にそれぞれのSAWデバイスを 形成し、2つの半分割体を円筒体に再び組立て、 適当な接合技術によって互いに固定し、対向する チャンネルにより形成された内側キャピティをシ ールする。SAW共振器からの電気配線に接合館 を貫通し、外部回路まで延長する。この構造体は ハウジング内に選択的に導入される流体からの圧 力等の外部圧力を選択的に受けることができるハ ウジング内に一般に取付けられる。圧力が加えら れる前と後の定常状態の間の2つのSAWデバイ スの周波数の差の変化は圧力変化の尺度として使 用される。先の出願には、このような構造体の例 が記載されている。

このタイプの構造の非制限的かつ代衷的使用例は探査用または産出油井内のダウンホール圧力を 検出することにあり、高圧および高温等の過酷な

ダウンホール条件および極小の圧力差を正確に測定しなければならないことによってこのような構造にはきびしくかつしばしば相容れない条件が護される。例えば、産出油井の探査を評価し計画、あるであって、例えばもの地層の透過性を評価するため、例えばその油井を一時的に閉じり、、同間計画することが好ましいことが時々ある。これには、困難なダウンホール条件下で比較的小の圧力変化を正確に測定することを要する。

従って、SAW圧力センサは、約百万倍以上のダイナミックレンジ、0~125℃より広い温度範囲で数秒以下の大きさの圧力応答時間、できるだけ短い熱応答時間および高精度を持った圧力測定能力を有していることが好ましい。上記とは異なるが、0~10.000円は、0.01円間温度にて100でステップで化したときに約10秒以下の熱レスポンス時間、およびフルスケールで0.025%の精度を有する

SAWE力センサにすることが好ましい。更に上記目標を越え、かつ上記分解能および精度と妥協することなく0~20,000psiを越える圧力レンジ、0~175℃を越える温度レンジ、数秒の大きさの圧力および温度応答時間を有する構造体を提供することが好ましい。

特開昭62-157543(4)

直であり、壁の交差部での応力を軽減するようと 計されたシャープなコーナーをある程度 文本のでかったのでなっていたででかってないでででかってないが、ではまってないが、前記を明はないが、前記を関立する必要はないが、前記を変けないが、前記を変けないが、でででは、一つでは、一つでは、一つでは、一つない。

1982年の出願に開示されかつ請求された構造体は従来の提案例よりも大きく改良されているを表えられているが、またより改良する必要を満たすようはみをしてがある。このような必要を満たすようはみをしてがイスのすぐ倒価に位置する例望をれずることによりすなわち丸くすることにより傾斜させることにより構造体の形状を変えることおよび/または(ii)2つのフラット面の壁厚が熱レスポンスを互いに

良く一致させるよう内側フラットの一つに隣接するセンサの外面を平らにすると予期しない大きな改良が生じることが判った。これら改良とは、応力に大きな悪影響を与えることなく感圧性が予想もしない程大きく増加することなく熱応答が予想もしない程大きく増加することである。

ング用工具にて形成できる。これら2つのチャンネルは(少くともセンサを製造するときは)一方のフラット面における本体の壁の厚さが他方のフラット面における壁の厚さよりも大きくし、フラット面の幅が異なるように2つのチャンネルの深さが異なるようにできる。フラットの一方に隣接するセンサの外側表面は感圧性を許容できないほと劣化することなくフラット面における熱応答を良好に整合するよう平坦にすることができる。

広機には本発明の非制限的実施例は中空本体の内側に形成され、本体の外側に加えられる単デバイののSAWデバイスを有する中空体から成る。SAWデバに開接する内側表面の少くとも一部の部分はわんとでは実質的に90°を超える内度に中空体は中での内側に形成されかつ互いに対向する2つのファルでは、ファット面を有する。それでも、ファット面にけるセンサ本体の壁の厚さはそれぞれのSAWデバーを表現していると、ファットを表現では、ファットを表現では、ファットを表現では、ファットを表現では、ファットを表現では、ファットを表現では、ファットを表現であると、ファットの壁の厚さはそれぞれのSAWデバーを表現であると、ファットを表現である。ファットを表現であると、ファットを表現であると、ファットを表現であると、ファットを表現であると、ファットを表現であると、ファットを表現であると、ファットを表現である。

イス間の熱応答を良好に整合するためマッチング できる。

両フラット面に隣接する平面状例壁を有する特定実施機械と比較して1つのフラット面に隣接するわん曲した例壁を有する特定の実施機構ではフラット面の中心において応力を大巾に増加することなく50% 窓圧性が増加することが予想される。フラット面におけるセンサ本体の壁の厚さを整合すると感圧性を許容できないほど労化、または応力を許容できないほど増加することなく少くとも約3分の1だけ熱応答時間が短くなることが予想される。

図面に示した実施 腹機と関連させて本発明の上 記およびそれ以外の特徴についてより詳細に説明 する。

第1図の斜視図および第2図、第3図および第4図の断面図を参照すると、番号10で一般的に示される外部負荷型圧力センサは軸平面に沿って16で接合され頂部半分割体12および底部半分割体14から成る。頂部半分割体12内には軸方

特開昭62-157543 (5)

向に延長するチャンネル18が形成され、底部半 分割体14内には同様な(しかしチャンネル18 より浅い)軸方向延長チャンネル20が形成され ている。これら2つのチャンネルは互いに対向し、 頂部半分割体12と底部半分割体14によってシ ールされたキャピティを形成している。頂部チャ ンネル18の底部には軸方向に延县する頂部フラ ット面22が形成され、チャンネル20の底部に は軸方向に延長する底部フラット面24が形成さ れている。フラット面22および24はチャンネ ル18および20により形成されたキャピティを 横断して互いに対向し、頂部フラット面 2 2 に頂 部SAW共振器26が形成され、底部フラット面 2 4 に底部共振器 2 8 が形成されている。本体 10を構成する半分割体の外観のこれ以上の細部 は第9図から徐々に明らかとなるが、第9図は底 部半分割体14の半分の斜視図であり、他の部分 は第9回にて底部半分割体14が切断されている 平面30に対して実質的に対称的である。ここで 「実質的」という用語を使用したのは、第4図に

最良に示すように 2 つのチャンネルの深さが異な り、かつ2つのフラット面でのセンサの壁の厚さ が異なることがあり得るからである。第9図から 判るように底部フラット面24の長辺はまっすぐ な(平面状)の側壁32および34の側面に位置 し、これら側壁はフラットの長辺から実質的に 90°より大きい傾度に傾斜している。このフラ ット面は切頭円錐の形状をしたルーティング工具 を用い軸方向平面に沿って中実円筒体の半分割体 をルート削切することにより形成できる。頂部半 分割体12も同じ形状にできるが、チャンネル 18および20は深さが異なる場合がある。チャ ンネル18は20の深さが異なるとき頂部の厚さ (頂部フラット面22より上方のセンサ本体の壁 厚) は底部の厚さ (底部フラット面24より下方 のセンサ本体の厚さ) と異なる。非制限的寸法例 を示す第2~4図の実施艦様では、頂部フラット 面での厚さは4 ∞で、底部フラット面での厚さは 6 m である。別の非制限的寸法例を示す、第5図 では、頂部の厚さは5.79まで、底部の厚さは

3.17 mである。これら寸法例の各々では所定センサの対向するフラット面は同一幅(第2~4図では、5 m、第5図では6.350 m)を有するが、このような例と同じようにする必要はなく、同一センサのフラット面の幅が互いに異なるようにしてもよい。

| 図に示されたものである。符号 L / r が付けられ た欄は先の欄に示された厚さとセンサ本体の半径 の比を示す。符号STが付けられた棚は、STカ ットのセンサに対する外部から加えられた圧力の 単位変化あたりのそれぞれのSAWデバイスの極 算周波数変化(単位はHz/psi)を示し、符号 ATの付いた個はATカットセンサに対する外部 から印加された圧力の単位変化あたりの周波数変 化を示す。衷しにおける感圧性の概算値に対する 基準発振器の周波数は310Hz である。外部圧 力を加える方法の例は、第14図を参照して説明 し、SAWデバイスの周波数を測定する方法の例 は第11~13図を参照して説明するが、これら 方法は上記1982年の米国特許出願にも記載さ れている。この1982年の特許出願にはSTお よびATの用語がより詳細に定義されている。

妻 1

	t (==)	t/r	ST(Nz/psi)	AT(z/psi)
Δ f / Δ p	5.79	0.456	38.0	20.0
Δ f / Δ p	3.17	0.250	50.0	28.4

第2~4図、第5図および第9図内のフラット 面の側面に位置するまっすぐな(平面状)側面を 使用する実施態機は従来の提案例と比較して良好 な概算された結果を与えるが、フラット面の少な くとも一方の側面に位置する側壁を丸くすると、 予期しないほど改善された結果を与えること、こ の予期しない改善はきわめて大きく、センサの性 能を劣化するような応力の増加を伴うものでない ことが判っている。

一例として、第6図を参照すると、第5図の実施 機と同じように頂部フラット面22(厚いフラット面)の側面にはまっすぐな側壁36および38が位置しているが、底部フラット面24(薄

辺の各々側面にはわん曲した側壁42が位置しているが、一方底部フラット面24の側面には第2~5 図および第9 図の実施態様のようにまっすぐな壁44および46 が位置している。

第8図は頂部および底部が丸いこと(Top and Bottom Round)の略語としてTBRと表示される別の実施態様を示す。第8図の実施態様では、底部(または薄い)フラット面24の側面には第6図の実施態様と同じように丸い側壁40が位置し、頂部(厚い)フラット面22の側面には第7図の実施態様のように丸い側壁42が位置する。

少なくとも一つのフラット面の側面に位置する 丸い側壁を使用すると、予期しないことに感圧性 がおどろくほど改善されることおよびこのことが フラット面の中心における応力を認容できないほ ど大きくすることによりセンサの性態を劣化する ものでないことが判った。下記の衷 2 は、フラットの中心における優算された感圧性を衷 1 と同じ 表示を用いて表示するもので、第8図(TBR)、 第7図(TR)および第6図(BR)のセンサを

いフラット面)の左右の側面にはわん曲した側壁 40が位置する。わん曲した倒壁40を有する底 部チャンネル20は、頂部チャンネル18と実質 的に同じようにすなわちルーティング用工具によ って形成できる。しかしながら底部チャンネル 20用のルーティング用工具は庇端を有し、この 庇端は (底部フラット24を形成するよう) 平ら な底部断面を有する半球状の形状になっている。 丸い側壁デバイスを有するセンサの半分割体を示 す斜視図である第10図を説明すると、この図は 底部フラット面 2 4 の長辺の側面にわん曲した側 壁40が位置する点だけが第9図と異なっている。 第6図に示すセンサ構造体は底部チャンネル20 だけが丸いすなわちわん曲した側壁40を有して いることを示すため底部が丸くされている(Bottom Round) ことの略語としてBRと衷示する。

第7図にはわん曲した側壁を有する別の実施態様を示すが、頂部が丸く(fop Round) されていることの略語としてTRと表示する。第7図において、頂部(すなわち厚い)フラット面22の長

用いたときの概算結果との比較を便利にするため 衷1(第5図に示す圧力センサ)の内容を繰返し て表示する。STおよびAT欄の値は表1に関連 して他のすべてのテストパラメータを用いた外部 から加えられた圧力の単位変化あたりのそれぞれ のSAWデバイスの周波数変化(Hz /psi)で ある。

叏 2

	t (ss)	t/r	ST (IIz/psi)	AT (IIz/psi)
第 5 図				
Δ f / Δ P	5.79	0.456	38.0	20.0
Δf/ΔP	3.17	0.250	50.0	28.4
TBR(第8図)			
Δ f / Δ P	5.79	0.456	38.9	24.8
Δ f / Δ P	3.17	0.250	54.7	39.2
TR(第 7 図	1)			
Δ f / Δ P	5.79	0.456	39.1	25.4
Δ f / Δ P	3.17	0.250	50.5	27.1
BR(第6図	1)			
Δ f / Δ P	5.79	0.456	37.9	19.6
Δ f / Δ P	3.17	0.250	54.2	41.6

センサBR(第6図)の2つのフラットに対する圧力の単位変化あたりのSAWデバイスの周波

第5図のセンサと比較するような感圧性の差の低下が(頂部フラットにわん曲した側壁が隣接し、了底部フラットにおもは目されるが、第6図のBRセンサに対しては感圧性大幅増加が注目される。これら結果からSTカットおよびATカットして結晶から製造されたセンサは、第2~5図および第9図における形状と比較してBR形状では50%の感圧性の改善を示すことができる。

フラット面の少なくとも一つに隣接する側壁を 丸くすることによって生じる予想されない概算感 圧性の大幅増加はフラット面の中心での応力とは ウルに対きくすることなく起きる。このことは を第 5 図に示した形状の場合の次の表3に一つ に概算結果より明らかである。軸方向(円向に たる2 2 方向およびフープ応力を る 2 - Q方向に対し正規化された応力Σが与えら れる。いずれのケースでも外部から加えられる圧 数変化は大きなコントラストをなすことおよびこ のことはSTおよびATカットの双方についても 云えることが衷 2 から判る。第 5 図に示すように **阿フラット面に隣接する側壁がまっすぐ(平面状)** であると、概算される感圧性の差はSTカットで は12 liz/psi である。この値は、底部フラット 面の側面にわん曲した(球面状)側壁が位置する 第8図のTBRセンサでは15.8まで変化し、底 部フラット面の側面にわん曲した側壁が位置し、 頂部フラットの側面にまっすぐな側壁が位置する 第 6 図のBRセンサでは 1 6.3 まで変化する。 ATカットでも概算された感圧性の差が改善され ることに注目したい。すなわち(第5図に示すよ うに) 両フラット面に隣接するまっすぐな何壁の センサでは8.4、両フラット面にわん曲した側壁 が隣接している) 第8図のTBRセンサでは14.4、 底部フラット面にわん曲した側壁が隣接し、頂部 フラット面にまっすぐな側壁が隣接する第6図の BRセンサでは22である。STカットでは、 (阿フラット面に隣接するまっすぐな壁を有する

カpsi ごとの応力である。第3図の他の表示は衷2の表示と同じである。予期しないことに、わん山した個壁に関連したセンサの本体が薄くなると、STカットまたはATカットのいずれでも応力は大きく増加しない。従って、概算された感圧性大幅に増加することを確保するため代債としてセンサの強度を大きく低下することはない。

				
	t(m)	t/r	ST	ΑT
第 5 図				
軸方向応力	5.79	0.456	-1.66	-1.62
フーア応力	5.79	0.456	-2.26	-2.25
铀方向応力	3.17	0.250	-2.16	-2.13
フープ応力	3.17	0.250	-2.88	-2.84
TBR (第8図)				
轴方向応力	5.79	0.456	-1.59	-1.57
フープ応力	5.79	0.456	-1.90	-1.87
植方向応力	3.17	0.250	-2.06	-2.03
轴方向応力	3.17	0.250	-2.00	-2.00
TR (第7図)		-		
軸方向応力	5.79	0.456	-1.57	-1.54
フープ応力	5.79	0.456	-1.80	-1.77
軸方向応力	3.17	0.250	-2.23	-2.20
フープ応力	3.17	0.250	-3.09	-3.06
BR (第6図)				
軸方向応力	5.79	0.456	-1.68	-1.65
フープ応力	5.79	0.456	-2.35	-2.34
铀方向応力	3.17	0.250	-1.99	-1.96
フープ応力	3.17	0.250	-1.79	-1.72

共振器 2 6 および 2 8 の各々は第 1 1 図に示す タイプのものでよく、1 9 8 2 年の特許出願に記 載のかつ公知の技術に従いそれぞれのフラット面 の高度に研摩された表面 4 8 にデポジットされた 表面波インターデジタルトランスジューサ 4 4 お よび 4 6 と、それぞれのフラット面の表面に形成 された表面波格子反射器 5 0 および 5 2 から構成 できる。表面波はフラット面の長手方向およびセ ンサ本体 1 0 の円筒軸に平行に伝播する。

第11図に示したタイプのSAW共振器および これをドライブして出力するための回路の簡単 したプロック図である第12図を参照すると SAW共振器は54で略図で示され、第1図に 56および58等で示すリード線を介して接続された出力端を有する。これらリード線は、頂部半 分割体12と底部半分割体14との間のシールに 技術できる。この外部回路基板に通当すな れた接合のアンプ60と、方向性カップラーな わちパワースプリッタ62および出力パッファ

ンプ 6 4 を含むことができ、アンプ 6 4 は S A W 共振器 5 4 の特性で決まる周波数の信号を出力ライン 6 6 に発生する。これら共振器の特性は、センサの本体に加えられる圧力による変化によって変わる。

されるものは多くの入力サイクルが主ゲートを通 過できるのに必要なタイムベースの期間の数であ る。入力サイクルごとの時間(信号の期間)が計 算され、次にその逆数が計算されると、測定され た周波数が得られる。時間カウンタ84内では時間 間ベースサイクルがカウントされ、イベントカウ ンタ86内で入力サイクルの数がカウントされる。 減算回路90内で必要な積および比が生じ、この 結果はディスプレイ92に表示される。

第14図には、静水圧測定用センサ10を使用 するための装置の例が示されている。この装置は 圧力センサ10が分離サポート106により適当 に支持されているハウジング104へ加圧流体を 供給するよう導管102を選択的に開けることが できる入力パルブ100を含む。センサ10まで の電気的配線は、センサ10内のSAWデバイス の周波数を測定するための外部回路、例えば第 13a図および第13b図に関連して説明した回 路に接続された貫通リード線112および114 である。ハウジング104内の圧力は、出力バル ブ110によって制御された出口選管108を介 して流体を抜くことにより緩和できる。代替例と して一つのポートを設け、センサの本体の円筒軸 に沿って延長する弾性支持体によりセンサ本体を 取付け、ハウジング内に液体を導入する壁と反対 の壁を通して電気配線を接続してもよい。種々の 異なるハウジングを利用できることおよび重要な ことはハウジングの特定の細部でなくハウジング が存在することであるので、請求する発明を実施 するのに特定のハウジングをこれ以上説明することは不要であると考えられる。

第14a図は、検層ツールシステム内に本明細 哲に述べたタイプのセンサを組込むことを示す。 第1~10、15、および19~22図に関連し て説明したタイプのセンサは、第14図に関連し て説明したようなハウジング内に固定され、検層 ツール130内に取付けられ、検層ツール130 は、地変下の地層134内にあけられたボアホー ル132内にケーブル131によって支持される。 ケープル131はプーリ136をまわって、ドラ ムーウインチ機構138に固定される。機構138 は、ケーブル131内の導電線と表面ユニット 1 4 2 との間を電気的に接続するための適当なブ ラシースリップリング装置140を含み、表面ユ ニット142は検層ツール130およびこの中に 取付けられたセンサに電力および制御信号を供給 する。第12~13b図に関連して説明したよう な回路はツール130内に取付けられ、センサに よって検出された圧力を検出する信号をケーブル

131を介して送出するようでは、シール130内により作動する。所望の場合、ツール130内により作動するを設け、センカを設け、センカを設け、センカを設け、センカを設け、センカードがパータを設け、センタルは号に係合し、アンカードがパータをででプル131と係合し、アンカーが表が、シール131と係合し、アンカーがでででは、カール131とでででででは、カール131とででは、カール131とでででは、カール131とででは、カール131とでは、アンカーの

(第6~8図に示したような) SAWデバイス に隣接したわん曲した壁を有する本発明のセンサ は、先に出願された特許出願に記憶されたセンサ の場合に使用された実質的に同一技術を用い製造

できる。材料の違いは必要なわん曲した側壁の形 成に関連したものである。すでに指摘したように これを形成する代表例は先願の出願におけるよう に円錐形でないルーティングツールを使用するこ とであるが、特定のSAWデバイスに隣接する例 壁の所望の曲率に応じて球面またはそれ以外のわ ん曲した切削面となったルーティング用ツールを 使用することである。例えば、フラット面の長辺 に隣接する側壁は、応力が増加する点から見て許 容できない劣化を生じることがなく改善された窓 圧性の所望の結果が得られる限り放物面でもよい し、横断軸断面が他の曲率を有していてもよい。 図示した実施態様では、SAWデバイスは沸の平 面状底面上に形成されている状態で示されており、 「フラット」なる用語を使用しているが、わん曲 した内面にSAWデバイス少なくとも一つを形成 することは本発明の範囲内にあると解すべきであ る。例えば、横断軸方向横断面にチャンネルの少 なくとも一つを連続的にわん曲させ、上記図面に 示したように平面状表面上でなくわん曲した底部

部分にSAWデバイスを形成してもよい。従って 「フラット面」なる用語は、本願ではSAWデバ イスを形成する衷面を意味するものとして使用し、 この表面は平らな面、わん曲した面、または部分 的に平らな面、および部分的にわん曲した表面で よい。更に上記図面では、SAWデバイスは軸方 向に沿って延長しているが、ある場合ではセンサ 本体の円筒軸に対して所定角をなす方向に沿って このSAWデバイスを延長させると好ましいこと があり、このようにすることは本発明の範囲内に 入ると解すべきである。また頂部、庭部および左 および右といった方向に関する用語はセンサの特 定配列に含及した用語であり、実際に使用する場 合にセンサを配列できる態様についての限定を意 味するものではない。本発明の範囲内では、上記 以外の多数の変形例も可能であり、従って、本発 明は上記特定例のみに限定されず、添付した特許 請求の範囲に含まれるすべての要旨を含むもので ある.

先に指摘したように、上記タイプのセンサの好

第5図に示された構成のセンサの概算された熱応答時間は第6図の曲線にプロットされるが、このグラフでは機軸は時間(秒)で、縦軸は対数尺の温度(で)で示された温度である。第16図の曲線120は、時間ゼロ時に要面温度が100でステップ変化したときの薄いフラット面24(第

5 図)とフラット面 2 4 の直下のセンサの外面における温度差を示し、第16 図の曲線 1 2 4 は同様に表面温度を同じだけステップ変化したときの厚いフラット面 2 2 とフラット面 2 2 のすぐ上のセンサの外面における温度差を示す。本例では、薄いフラット面における温度差が 0.1 でに達するのに要するのに必要な概算された時間は約8秒であり、厚いフラット面の温度差が 0.1 でに達するのに要する機算時間は約15秒である。

第17図は第16図と同じタイプのグラフであるが、このグラフは第8図に示すような内壁構造を丸くした場合のグラフである。第17図に示すように確いフラット面における温度差が0.1℃なったのに要する時間は約5秒まで短くなるのに要する時間は約15秒である。従って、センサの全然応答は大幅には変化しない。2つのSAWデバイスの外部を平らにすること等によりSAWデバイスの一方の本体の壁を薄くすると、予期しない

ことに他のパラメータに許容できない悪影響を与えることなくセンサの熱応答時間を大幅に改善できることが判った。また予期しないことにこのことは感圧性の許容できない低下または応力の許容できない増加を生じるものでないことが判った。

特開昭 62-157543 (11)

した外側の「フラット面」にすることは本発明の 範囲内にある。例えば、センサの本体の外側表面 を研削して厚いフラット面22に平行なフラット 平面を形成することにより、第15図における 126のように外側のフラット面を形成できる。 このような外側フラット面126により、厚いフ ラット面22および薄いフラット面24における センサ本体の半径方向厚さはほぼ同じになる。厚 いフラット面22におけるセンサ本体の厚さは、 本例では3.00mで、薄いフラット面24におけ るセンサ本体の厚さは本例では、3.17mである。 第18図の曲線120は、薄いフラット面が第 15図の構成となっているときの概算熱応答時間。 を示す。この曲線120は、第8図の構成の場合 を示す第17図の曲線とほぼ同じであるが、第 18図の曲線124は厚いフラット面22が第 15図の構成となっている場合の大幅に短くなっ た概算熱応答時間を示す。よって、温度差が0.1 でまで低下するのに(第16図および第17図に 示すように)他の構成では15秒要していたが約。 1 0 秒要する。これによって、熱応答時間は約 3 分の 1 だけ短くなることが推定される。

厚いフラット面におけるセンサ壁を薄くするこ とによって熱応答時間は余熱できないほど大幅な 改善がされることは、上記した各種のセンサの構 成の各々では有益である。第19~22図にこれ ら構成のいくつかを示す。第19図の構成は、第 5 図の構成と同じであるが、外側のフラット面 126は厚い (頂部) フラット面22におけるセ ンサ壁の半径方向厚みを3㎜まで瘫くするよう厚 いフラット面22に外側フラット面126が形成 してある。第20図の構成は、第5図の構成と同 じであるが、薄いフラット面 2 4 におけるセンサ. 本体の半径方向厚さは、3.17mmでなくて2.17 maであるので、1 ma薄い。第21図の構成は第8 図の構成と同じであるが、薄いフラット頭24に おけるセンサ本体の半径方向厚みは1m薄い。第 22図は第21図と同じ構成を示すが、外側フラ ・ット面126は厚いフラット面22におけるセン サ壁厚を第21図に示す5.78 mmから3.00 mmへ

薄くしている。

第15、19、20および22の構成は、完全に円形の機方向機断面を有する対応した構成は 較される改善された(短くなった)熱応答時間を 有する。先に指摘したように、熱応答時間の短縮 に関連する本発明の特徴の重要な予期しない利点 の一つは、応力が許容できない程増加または感に 性が許容できない程低下しないことである。これ は、次の表4に示す概算結果により確認される。

安 4

センサの構成	正規化され た仙方向 応力	正規化され たフープ 応力	您压性 (liz/psi)	フラット⑪(おけるセン* の壁圧(ss)
・ すべてまっすぐな側型 爪部フラット间 底部フラット頃	-1.65 -2.12	-2.26 -2.88	37.62 50.34	5.79 3.17
B すべて丸い側壁 頂部フラット阿 座部フラット回	-1.59 -2.06	- 1.87 - 1.99	39.15 54.83	5.79 3.17
C すべてまっすぐな個型 外側フラット阿 川部フラット阿 庇郎フラット阿	- 1.35 - 2.21	-1.58 -2.77	33.18 52.63	3.00 3.17
D すべて丸い 側壁 外側フラット 面 水部フラット面 底部フラット面	-1.11 -2.09	-0.62 -1.91	33.55 56.61	3.00 3.17
B すべてまっすぐな何塾 頂郎フラット面 応郎フラット面	-1.73 -2.64	- 2.51. - 3.54	38.18 60.91	5.79 2.17
ド すべて丸い側壁 頂部フラット町 底部フラット面	-1.67 -2.53	-2.11 -2.02	39.74 71.27	5.79 2.17
G すべて丸いフラット面 外側フラット面 瓜郎フラット面 必郎フラット面	-1.15 -2.68	-0.87 -1.96	32.90 77.18	3.00 2.17

特開昭62~157543 (12)

表 4 の A 部分は第 5 図に示すような構成の場合 の結果を示し、衷4のB部分は第8図に示すよう な構成の場合の結果を示し、患4のC部分は第 19図に示すような構成の場合の結果を示し、D 部分は第15図に示すような構成の場合の結果を 示し、B部分は第20図に示すような構成の場合 の特果を示し、F部分は第21図に示すような構 成の場合の結果を示し、表 4 の G 部分は第 2 2 図 に示すような構成の場合の結果を示す。表しにお ける正規化された軸方向応力と表示された關はそ れぞれのフラット面の中心における極質された応 力を示し、正規化されたフープ応力と表示された 欄はフラット面の中心における概算されたフーブ 応力を示し、感圧性と表示された棚は外部から加 えられた圧力の単位変化当たりのそれぞれのSAH デバイスの周波数変化(Hz/psl)を示し、フラ ット面におけるセンサ壁の厚さと表示された個は それぞれのフラット面の中心からセンサ本体の外 側要面上の最も近い点まで測定した厚さ (**)を 示す。

示す第4図と同じような機軸断面図、第6図は底 郎フラット面に隣接するわん曲した側壁を使用し た実施態様を示す機軸断面図、第7図は頂部フラ ット面に隣接するわん曲面を使用した実施態様を 示す横軸断面図、第8図は頂部フラット面および **底部フラット面の双方に隣接するわん曲した側壁** を使用した実施態様を示す機軸断面図、第9図は フラット面に隣接するまっすぐな側壁を有するチ ャンネルを示す斜視図、第10図はフラット面に 隣接するわん曲した側壁を有するチャンネルを示 す同様な斜視図、第11図はSAW共振器の主要 部品を示す斜視図、第12図はSAW共振器の主 要部品および共振器用の外部回路を示すブロック 図、第13a図はSAW発援器の周波数を直接カ ウントするための方法を示すプロック図、第13 b図はSAW発振器の周波数を測定するための時 間測定法を示すプロック図、第14図は静水圧測 定のため外部負荷型SAW構造体が取付けられた

ハウジングの略図、第14a図は油井検暦時にセ

ンサを使用する状態を示す図、第15図は感圧性

表4のA部分とC部分を比較すると、第19図に示すように外側フラット面126を形成しても第5図に示す構成と同じような構成と比較して動方向またはフーブ応力を大巾に増加するわけではなく、略圧性を増加させると同時に、熱応答時間を大巾に短縮することがわかる。表4のB部分とD部分を比較するだけでなく、F部分とG部分を比較すると同様な結論が得られる。 妻4には示していないが、表4のB部分に記載の構成上に外側フラット面を形成すればF部分からG部分に至るまでのような結果に対応する改善が予想される。4.図面の簡単な説明

第1図は外部負荷型SAWデバイス圧力センサの斜視図、第2図は第1図の円筒形構造体を2つの半分割体が接合されている軸方向平面における2-2線に沿う軸方向断面図、第3図は第2図の平面に垂直な軸方向平面における3-3線に沿った軸方向断面図、第4図は横軸平面における第1図の4-4線に沿った横断面図、第5図はフラット面に隣接する平面状側壁を使用した実施態様を

- 10…圧力センサ
- 12…頂部半分割体
- 1 4 … 底部半分割体
- 18、20…チャンネル
- 2 2 …頂部フラット面

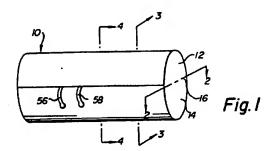
特開昭 62-157543 (13)

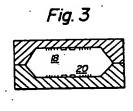
 2 4 ··· 底部フラット面

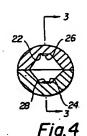
 2 6 ··· 頂部S A W共振器

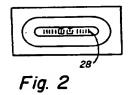
 2 8 ··· 底部S A W共振器

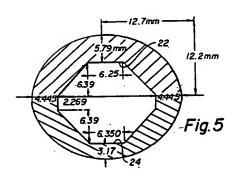
 3 3 、 3 4 、 4 0 ··· 個壁

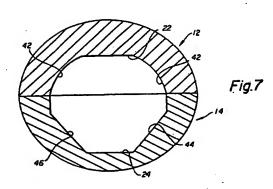


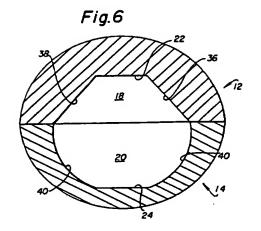


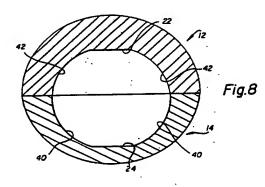




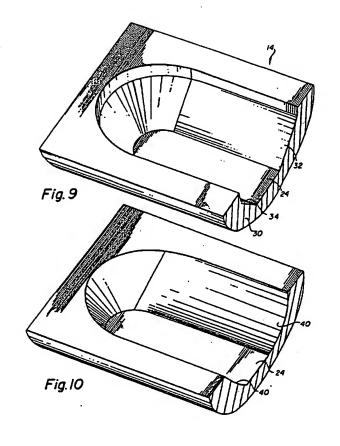


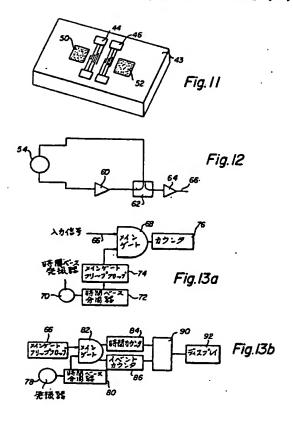


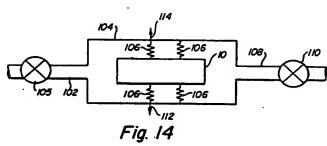


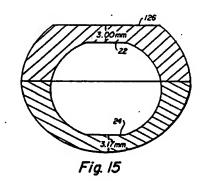


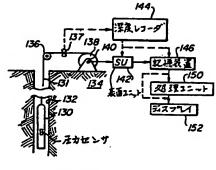
特開昭 62-157543 (14)







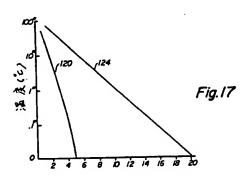


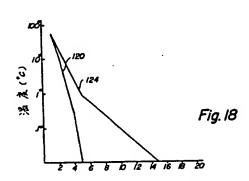


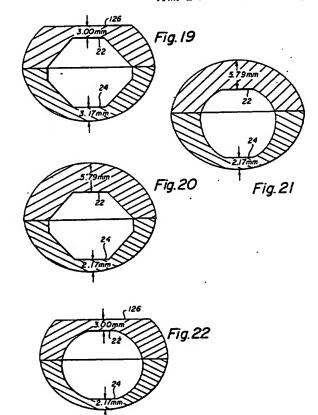
124 120 120 12 14 16 18 20 Fig. 16

Fig. 14A

特開昭 62-157543 (15)







TEAM WORK ORDER te: 7-9-07 Candice

Return Complet			Candice		
Client Completi			cable):		
Desired Date for	work reques	sted back (fir	st draft if a	pplicable): 7-1	2-07
☐ This item of	an be bumpe	d (without ap	proval) to 7-	13-07	
Do not bur	-	` -	- / -		
Actual Due Date	-				
PTO Due I		BSKB	Internal Du	e Date	
		Paper file		E-file	
Please see the s	ecretarial ma	anager for an	y requests 1	equiring less	than 48 hours
turn-around tin					
		TYPE OF WO			r enconnect de mang novembronen mentende et coescipi pipping (100
Rule 53(b)	- Divisional/0	Continuation	Application	-mail w/ new dkt	# must be attached)
l. Do we nee	d to make cha	inges to spec	(including p	eviously filed	
Amendments/Cr	oss Ref parag	raph?) 🔲 . Ye:	s 🔃 No		
2. Do we hay	e an Electro	nic Specifica	tion on P di	ive? Yes	No
Should pa	ragraph num	bering be in:	serted into t	he spec? 🛄 🏾	čes 🗌 No
Specificati	on/Substitute	Specification	1		
THE THE PERSON AND THE TRANSPORT OF THE PERSON AND	ED AS (ON P	NOTE: HER STEEL			
Amendme	and the second of the second of the property of the second	Contract to A 180			
	lize Draft Ame	endment/Rep	oly and send	to the client.	
	lize Draft Ame				
Type	Amendment	/Response fro	om scratch a	nd send to the	client.
Type	· Amendment	/Response fro	om scratch a	nd send to the	PTO.
Elec	tronic Spec.	and/or Clair	ns on P driv	e: Yes	No
Special Le					
<u> </u>	lize and send	to the client.			
	from scratch		the client.		
Notice of A					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pre-Appea	—	Appeal Brief			
☐ Fie-Appea			rom scratch		
	aring Request		Written Opin	ion	
PART AND	aring request		WITCEII OPIII		
RCE				Cinalize new A	mendment
			Issue Fee w/	Corr. Formal l	Travings
	w/312 Amend		issue ree w/	Coll. Folillai	Jiawiligs
	Formal Drawing	gs (Only)			
Notice of A	PROPERTY - CREATER AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE P				
	ed in PAIR and				
	ing has been no			ED, REMOVE.	
File Provis	ional Applicat				
Order Cer	tified Copies	☐ EOT Let		Abandon	
☐ Report/Re	minder - Noti	ce to file MP/	MR 🗌 C	ertificate of Co	orrection
IPERS				annual or the second se	remanded Sentropolishinoid for those
Client Let	er 🛛	Client Letter	(Send letter	by facsimile o	r email)
Debit					
	SANDONMENT	ি (do not se	nd confirma	tion copy of	client letter to thi
client	经制度 医海绵 医电影 医皮肤 医二角溶液 医毛皮膜 医骶骨炎				
Sementaring list of the Committee Co	A STATE OF THE PARTY CONTRACTOR C				

	Work prepared by:	Telephone Extension:
<u>.</u>	Date:	

•